



TSMC、ボッシュ、インフィニオン、NXP の4社、 欧州に先端半導体製造の合弁会社を設立

新竹、シュツットガルト、ミュンヘン、アイントホーフェン、2023年8月8日 - TSMC (TWSE: 2330, NYSE: TSM)、ロバート・ボッシュ GmbH、インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)、および NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI) は本日、ドイツのドレスデンにある European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) GmbH に共同出資し、高度な半導体製造サービスを提供する計画を発表しました。ESMC は、急成長する自動車および産業分野の将来的な生産能力ニーズに対応するための300mmファブ建設に向けた重要な一步となるもので、最終的な投資決定は、このプロジェクトへの公的資金投入の水準が確認されるまで保留されます。本プロジェクトは、European Chips Actの枠組みの下で計画されています。

今回計画されている工場は、TSMCの28/22 nm プレーナCMOSと16/12 nm FinFET プロセス技術で、月産4万枚の300mm (12インチ) ウェハの生産能力を持つ見込みで、高度なFinFETトランジスタ技術と約2,000人のハイテク専門職の直接雇用を創出することで欧州の半導体製造エコシステムをさらに強化します。ESMCは2024年後半に工場の建設を開始し、2027年末の生産開始を目指しています。

今回計画している合弁会社は規制当局の承認やその他の条件が満たされることを条件として、TSMCが70%を所有し、ボッシュ、インフィニオン、NXP がそれぞれ10%の株式を保有する予定です。投資総額は100億ユーロを超える見込みで、出資、借入金、欧州連合 (EU) およびドイツ政府からの強力な支援で構成されます。工場はTSMCが運営します。

TSMC の CEO、Dr. CC Wei 氏は次のようにコメントしています。「今回のドレスデンへの投資は、顧客の戦略的キャパシティと技術ニーズに応えるという TSMC のコミットメントを示すものであり、ボッシュ、インフィニオン、NXP との長年のパートナーシップをさらに深めるこの機会に興奮しています。欧州は、特に自動車や



産業分野など、半導体の技術革新にとって非常に有望な場所であり、欧州の優秀な人材とともに、当社の先進的なシリコン技術でこれらの技術革新を実現できることを楽しみにしています。」

ボッシュ取締役会会長、Dr. Stefan Hartung 氏は次のようにコメントしています。「半導体はボッシュにとって重要な成功要因であるだけではありません。世界の自動車産業の成功にとっても、半導体の安定供給は非常に重要です。ボッシュは、自社の製造施設を継続的に拡張していくだけでなく、パートナーとの緊密な協力を通じて、自動車部品サプライヤーとしてのサプライチェーンをさらに確実なものにしていきます。TSMC との提携により、ドレスデンにあるボッシュの半導体工場のすぐ近くで、半導体のエコシステムを強化するグローバル・イノベーション・リーダーを獲得できることを嬉しく思います。」

インフィニオン テクノロジーズの CEO、Jochen Hanebeck 氏は次のようにコメントしています。「私たちの共同投資は、欧州の半導体エコシステムを強化するための重要なマイルストーンです。これによりドレスデンは、すでにインフィニオンの最大のフロントエンド拠点がある、世界で最も重要な半導体ハブの 1 つとしての地位を強化することになります。インフィニオンは新たな生産能力を活用して、特に自動車と IoT の分野で拡大する欧州顧客の需要に応えていきます。この高度な能力は、脱炭素化とデジタル化という世界的な課題に対処するための革新的な技術、製品、ソリューションを開発するための基盤となるでしょう。」

NXP Semiconductors の社長兼 CEO、Kurt Sievers は次のように述べています。「NXP は、欧州におけるイノベーションとサプライチェーンの強化に全力で取り組んでいます。欧州連合 (EU)、ドイツ、ザクセン自由州が半導体産業の重要な役割を認識し、欧州の半導体エコシステムを後押しすることに真摯に取り組んでくれたことに感謝します。この新しい重要な半導体ファウンドリーの建設により、自動車および産業分野のデジタル化・電動化が急速に進む中で、必要なシリコンを供給するための技術革新と生産能力が加わることになります。」



ボッシュについて

ボッシュ・グループは、グローバル規模で革新のテクノロジーとサービスを提供するリーディングカンパニーです。2022年の従業員数は約42.1万人（2022年12月31日現在）、売上高は882億ユーロ（約12.2兆円*）を計上しています。現在、事業はモビリティ、産業機器テクノロジー、消費財、エネルギー・ビルディングテクノロジーの4事業セクター体制で運営しています。ボッシュはIoTテクノロジーのリーディングプロバイダーとして、スマートホーム、インダストリー4.0さらにコネクテッドモビリティに関する革新的なソリューションを提供しています。ボッシュは、サステイナブル、安全かつ魅力的なモビリティを追求しています。ボッシュはセンサー技術、ソフトウェア、サービスに関する豊富な専門知識と「Bosch IoT cloud」を活かし、さまざまな分野にまたがるネットワークソリューションをワンストップでお客様に提供することができます。ボッシュ・グループは、AI（人工知能）を搭載する、もしくはAIが開発・製造に関わった製品を提供することで、コネクテッドライフを円滑にすることを戦略目標に掲げています。ボッシュは、革新的で人々を魅了する全製品とサービスを通じて生活の質の向上に貢献します。つまり、ボッシュはコーポレートスローガンである「Invented for life」-人と社会に役立つ革新のテクノロジーを生み出していきます。ボッシュ・グループは、ロバート・ボッシュ GmbH とその子会社470社、世界約60カ国にあるドイツ国外の現地法人で構成されており、販売/サービスパートナーを含むグローバルな製造・エンジニアリング・販売ネットワークは世界中のほぼすべての国々を網羅しています。ボッシュは2020年第一四半期に、世界400超の拠点でカーボンニュートラルを達成しています。ボッシュの未来の成長のための基盤は技術革新力であり、世界136の拠点で約8万5,500人の従業員が研究開発に、そのうち約4.4万人がソフトウェアエンジニアリングに携わっています。詳細は www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse でご覧いただけます。

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約56,200人の従業員を擁し、2022年会計度（2021年10月～2022年9月）の売上高は約142億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所（銘柄コード：IFX）、米国では店頭取引市場のOTCQX（銘柄コード：IFNNY）に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp

Follow us: [Twitter](#) – [Facebook](#) – [LinkedIn](#)



NXP Semiconductors について

NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI) には、より良く、安全・安心なコネクテッド・ワールドを実現する画期的なテクノロジーを生み出すために優秀な頭脳がそろっています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードする NXP は、オートモーティブ、インダストリアル & IoT、モバイル、通信インフラの各市場で新たな可能性を拓く一方、より持続可能な未来を実現するソリューションを提供しています。60 年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXP は世界 30 か国強で約 3 万 4,500 名の従業員を擁しています。2022 年の売上高は 132 億 1,000 万米ドルでした。詳細は Web サイト www.nxp.com をご覧ください。

TSMC について

TSMC は 1987 年に設立され、お客様の製品の製造を受託する、専門ファウンドリビジネスモデルの先駆者です。業界をリードするプロセス技術と設計支援ソリューションのポートフォリオにより、世界のお客様とパートナーのエコシステムの成長をサポートし、半導体業界にイノベーションをもたらしています。アジア、欧州、北米において事業をグローバルに展開し、世界各地で企業市民としての貢献を続けています。

2022 年には 288 種のプロセス技術を展開し、最先端で特殊な高度パッケージング技術の幅広いサービスを提供することで、532 社のお客様を対象に 12,698 の製品を製造しました。本社は台湾の新竹に置いています。詳細は <https://www.tsmc.com> を参照下さい。

###

Press Contacts

Robert Bosch GmbH

Athanassios Kaliudis

Spokesperson connected mobility, software and automotive electronics

+49 152 08651292

athanassios.kaliudis@de.bosch.com



Infineon Technologies AG

Andre Tauber

Head of Corporate Media Relations

+49 89 234-36705

Andre.Tauber@infineon.com

NXP Semiconductors

Mike Silverman

Sr. Director of Global Public Relations

+1 979-350-9210

Mike.Silverman@nxp.com

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.

Nina Kao

Head of Public Relations

Tel: 886-3-563-6688 ext.7125036

Mobile: 886-988-239-163

E-Mail: nina_kao@tsmc.com

Ulric Kelly

Public Relations

Tel: 886-3-563-6688 ext. 7126541

Mobile: 886-978-111-503

E-Mail: ukelly@tsmc.com